



**Okamoto**

**株式会社岡本工作機械製作所**  
(証券コード：6125)

**2025年3月期第2四半期  
決算説明会資料**

**2024年12月9日**

## アジェンダ

1. 2025年3月期第2四半期  
決算概況と通期業績予想
2. 中期経営計画“INFINITY700”  
計画サマリーと進捗状況
3. Si貫通電極ウェーハ全自動研削装置

JST研究成果最適展開支援プログラム開発成功

Appendix

# 1. 2025年3月第2四半期 決算概況と通期業績予想

# 決算サマリ

## 業績

- ✓ 売上高200億41百万円、営業利益8億91百万円
- ✓ 1Qから2Qにかけて回復傾向にあるものの、ユーザーの生産調整による投資計画の先送りなどから、特に好調であった半導体関連装置の売上が前年同期に比べて大きく減少した

## 受注実績

- ✓ 半導体受注は低調だった前年同期を上回る
- ✓ 工作機械の国内は中小企業での投資鈍化など受け前年同期を下回る
- ✓ 海外では欧州はEV関連向け、光学機器向けに受注増加。中国は景気減速により新規受注伸び悩み

# 市場概況

## ■ 国内市場

- 工作機械は中小企業の投資鈍化や金型業界向けの平面研削盤やロボット向け歯車の需要が低迷、受注は前年同期を下回る推移
- 売上は自動車関連や工作機械業界向けの大型平面研削盤、半導体関連向けのロータリー平面研削盤の販売があるも精密歯車の販売が落ち込み前年同期から減少

## ■ 海外市場

- 北米市場は航空機向けを中心に工作機械受注回復も精密歯車の需要は低迷、販売も前期受注の低迷を受け減少
- 欧州はウクライナ問題の長期化やスエズ運河の通航制約など地政学的なリスクが影響し販売は減少も、受注はEV関連向けの大型平面研削盤や光学機器向けの超精密平面研削盤を受注し、前年を上回る実績
- 中国では景気低迷を受けEV関連向けなどの新規受注は低迷も、売上は大型平面研削盤などの受注残に支えられ前年を上回る

## 業績ハイライト

(単位：百万円)

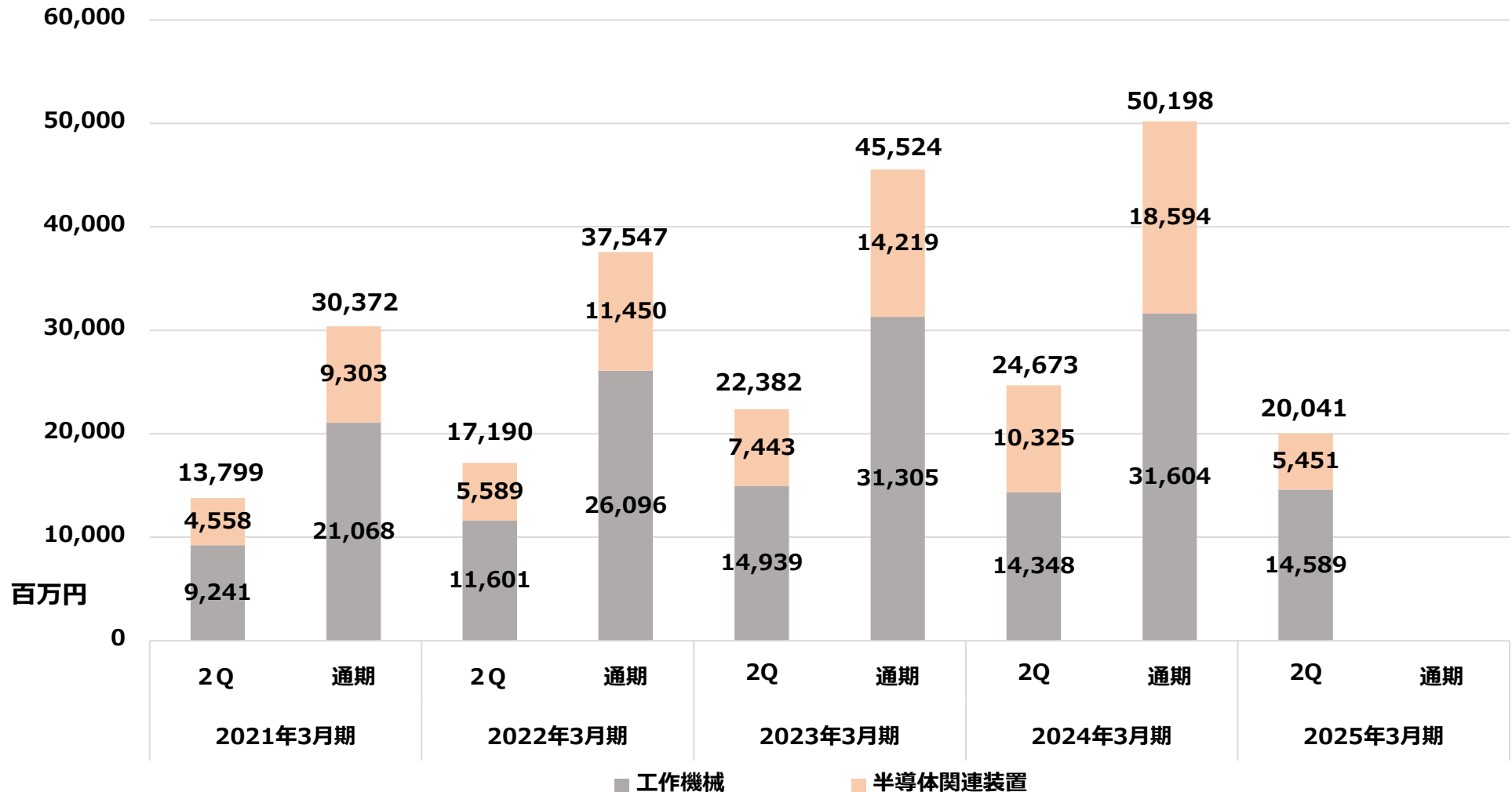
	2023年9月	2024年9月	
	金額	金額	前期比増減率
売上高	24,673	20,041	▲18.8%
売上総利益	7,527	5,719	▲24.0%
販売費及び一般管理費	4,619	4,828	+4.5%
営業利益	2,908	891	▲69.4%
経常利益	2,944	525	▲82.2%
当期純利益	1,860	312	▲83.2%

為替レート	2024年9月	2025年3月 (計画)
米ドル	152.45	136.00
シンガポールドル	114.37	100.00
ユーロ	165.83	144.00
タイバーツ	4.30	3.90
人民元	21.20	19.70

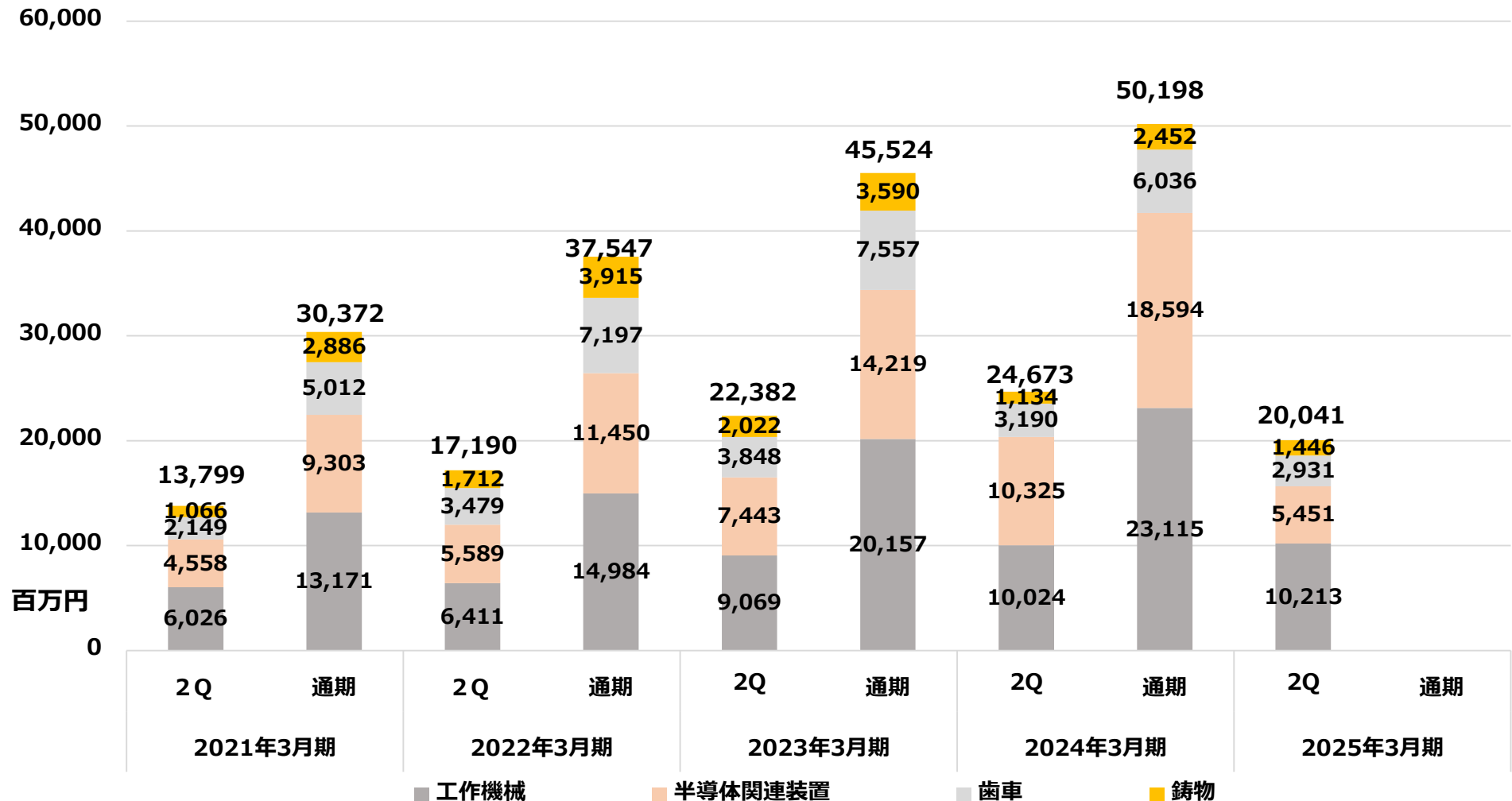
※期中の平均レートで記載しております。

## セグメント別売上高推移①

ユーザーの生産調整による投資計画の先送りなどを受け半導体関連装置の売上が減少



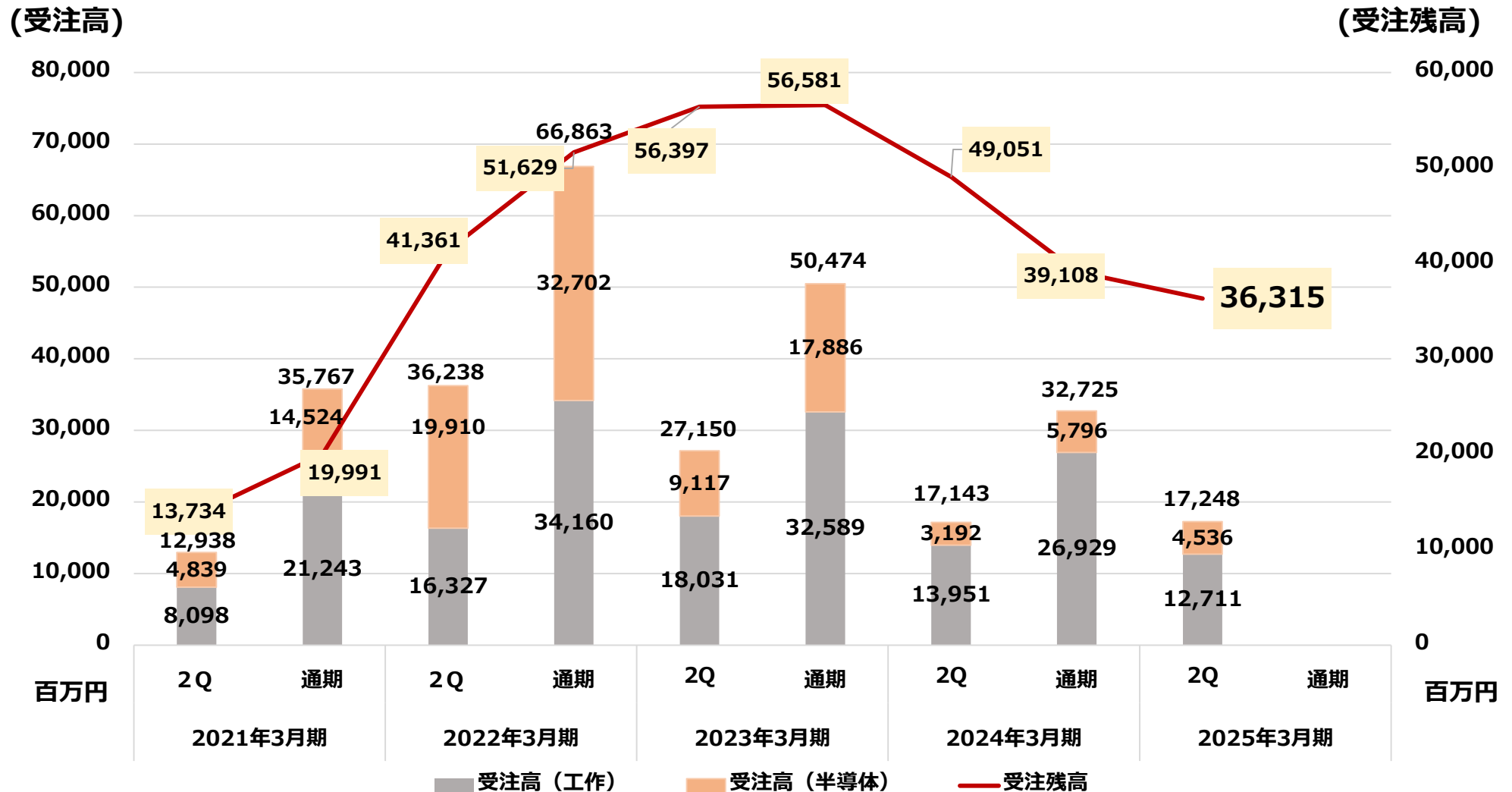
## セグメント別売上高推移②





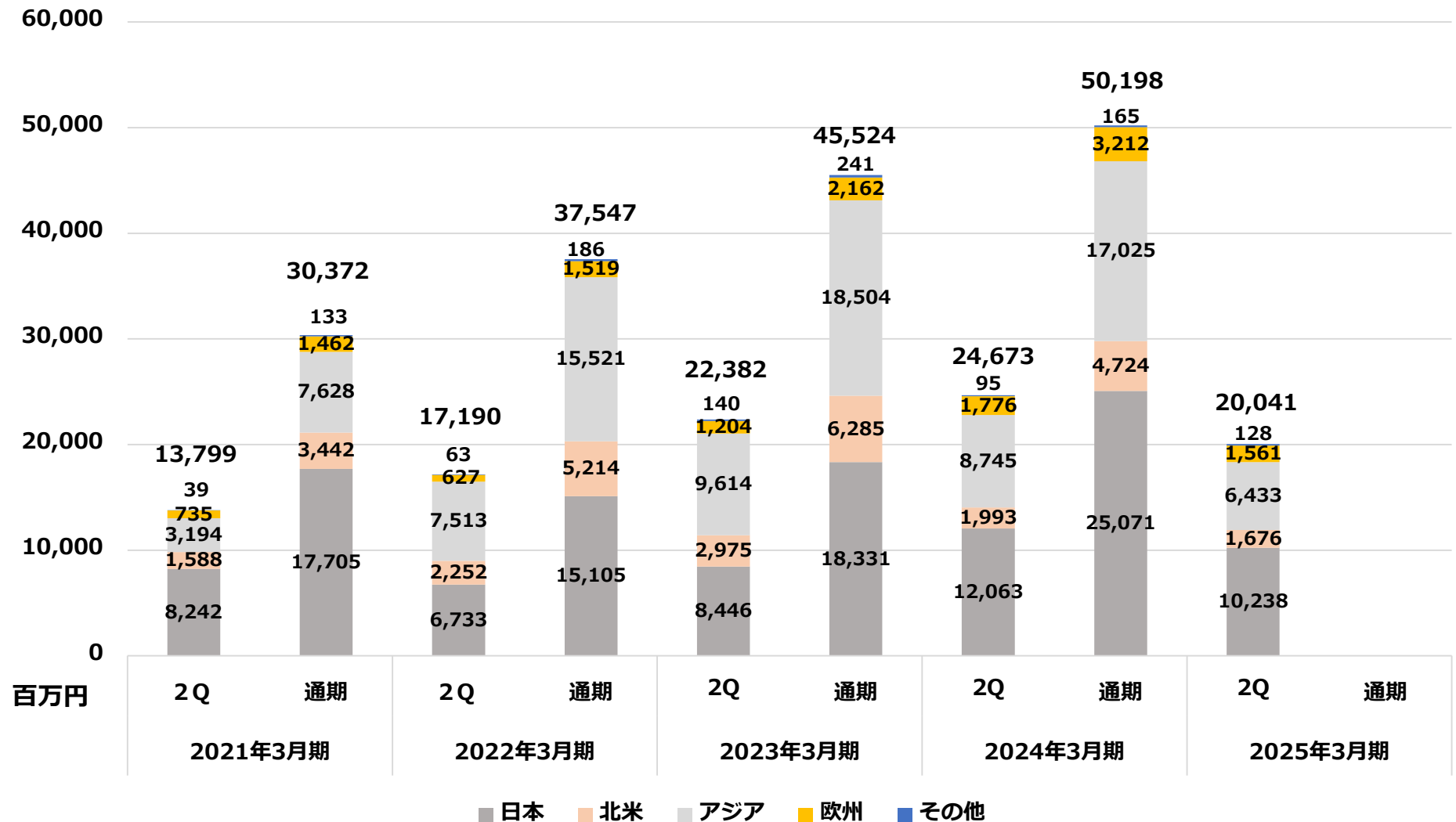
## 受注・受注残高

半導体関連装置については前年同期を上回る



# エリア別売上高推移

日本、北米では昨年好調だった大型平面研削盤の売上が減少



## 比較貸借対照表

(単位：百万円)

	2024年3月		2024年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
流動資産	42,564	48,321		+5,757
現金及び預金	11,895	9,071		▲2,824
受取手形及び売掛金	12,318	10,962		▲1,356
その他	18,350	28,288		+9,938
有形・無形固定資産	15,315	17,163		+1,848
投資等	2,284	2,346		+62
資産合計	60,164	67,832		+7,668

(単位：百万円)

	2024年3月		2024年9月	
	金額	金額	金額	対前期末比
負債合計	30,187	28,225		▲1,962
流動負債	23,982	21,561		▲2,421
固定負債	6,205	6,663		+458
純資産合計	29,977	39,607		+9,630
負債資本合計	60,164	67,832		+7,668

## 比較キャッシュフロー計算書

(単位：百万円)

	2023年9月	2024年9月	
	金額	金額	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	▲1,609	▲2,999	▲1,390
税引前当期純利益	2,930	519	▲2,411
減価償却費	859	1,020	+161
売上債権の増減（▲は増加）	▲2,288	1,322	+3,610
棚卸資産の増減（▲は増加）	▲60	▲1,478	▲1,418
仕入債務の増減（▲は減少）	628	▲1,798	▲2,426
その他	▲3,678	▲2,584	+1,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲2,250	▲1,261	+989
財務活動によるキャッシュ・フロー	▲228	9,510	+9,738
換算差額	327	▲75	▲402
現金・現金同等物残高	8,614	16,592	+7,978

# 通期業績予想

半導体市況の回復の遅れなど受注環境の悪化を受け、通期業績は前期比減収減益の予想

(単位：百万円)

	2024年3月	2025年3月 (予想)	
	金額	金額	増減率
売上高	50,198	45,000	▲10.4%
営業利益	6,133	3,600	▲41.3%
経常利益	6,284	3,600	▲42.7%
当期純利益	4,556	2,500	▲45.1%

(単位：百万円)

	2024年3月	2025年3月 (予定)
	金額	金額
設備投資額	2,982	1,494
減価償却費	1,834	1,930
研究開発費	283	172
為替レート	2024年3月	2025年3月 (計画)
米ドル	145.31	136.00
シンガポールドル	108.03	100.00
ユーロ	157.72	144.00
タイバーツ	4.12	3.90
人民元	20.20	19.70

※期中の平均レートで記載しております



## 2. 中期経営計画“INFINITY700” 計画サマリーとその進捗

# INOFINITY700 ロゴと名称の由来

名称は社内公募で決定

中計期間は2024年4月～2028年3月（4ヶ年計画）

「ビジョン2030」からバックキャストして目標・施策を策定

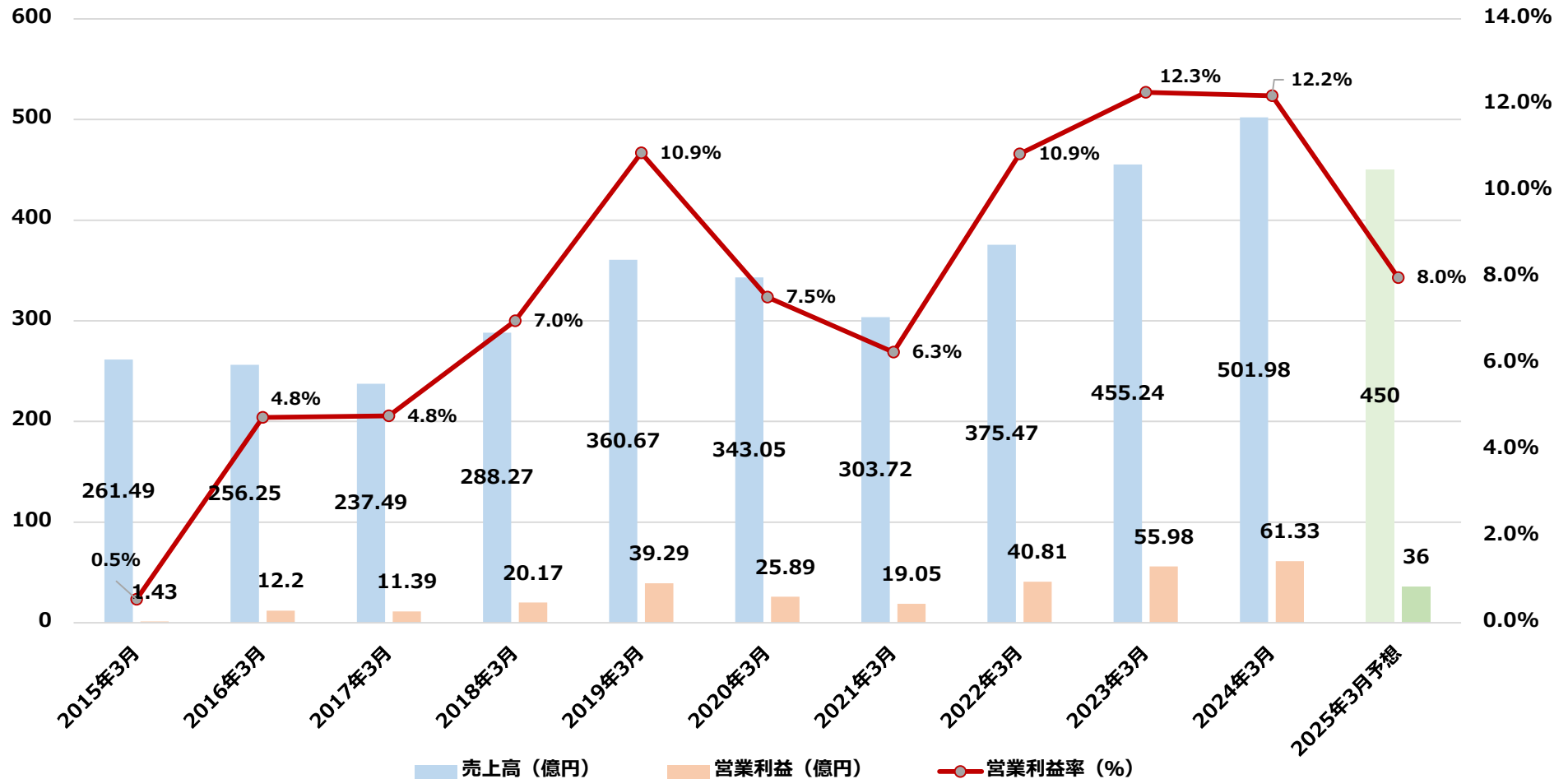


**700**  
**INOFINITY**

- \* INOFINITY Innovation（革新）とInfinity（無限）を掛け合わせた造語
- \* 700は「ビジョン2030」の目標 売上高700億円から

# 計画の背景 長期業績推移と通期予想

前中計目標は1年前倒しで達成も、今期は業績の踊り場  
半導体などシクリカルな市場に対し、もう一段ステージを上げた打ち手が必要





# 中長期戦略「ビジョン2030」

2030年に「ありたい姿」を検討。昨年11月、中長期戦略「ビジョン2030」発表  
中長期戦略の達成に向け5月には三井物産と資本業務提携

## 長期ビジョン

世界に類のない「総合砥粒加工機メーカー」として、  
平面研削盤・半導体ウェハ研磨装置でグローバルNo.1を目指す

## 財務目標

連結売上高：700億円  
ROE:17～18%

連結営業利益率：16%  
連結配当性向：45%以上

# 提携で期待するシナジー

今後の成長に向けて資本業務提携が大きな力に

## 工作機械事業

## 半導体関連装置事業

### 販売

- ・ 新規顧客・未開拓地域の市場開拓  
(米国、インド市場を始めとした海外での拡販：米Ellison Technologies Inc.等との連携)

- ・ 既存顧客とのリレーション強化
- ・ 新規顧客の開拓（特に次世代半導体材料のユーザー開拓：米国市場、欧州市場）

### 調達

- ・ 調達連携によるコストダウン
- ・ 新規調達チャネルの開拓
- ・ 長納期部材等に対する購買力の強化

### 開発

- ・ 先端動向等の情報収集を強化し、開発戦略及び販売戦略の軌道修正を迅速化
- ・ 成長投資による開発促進
- ・ メカ以外の分野（材料/素材/プロセス/関連部材等）における知見の活用によるソリューションの最適化、およびアライアンスの促進
- ・ 知的財産管理・活用の強化

# 今期トピックス Ellison Technologies, Inc.との提携強化

2024年9月 当社の100%子会社Okamoto Corporation（本社イリノイ州）は三井物産の100%子会社Ellison Technologies, Inc.（本社カリフォルニア州）と米国における当社工作機械及び半導体関連装置の販売強化に向けて覚書を締結



**工作機械**

→ **高付加価値製品の販売体制を強化**

**半導体関連装置**

→ **化合物半導体関連の顧客開拓を推進**

# <ご参考> 米Ellison Technologies, Inc.

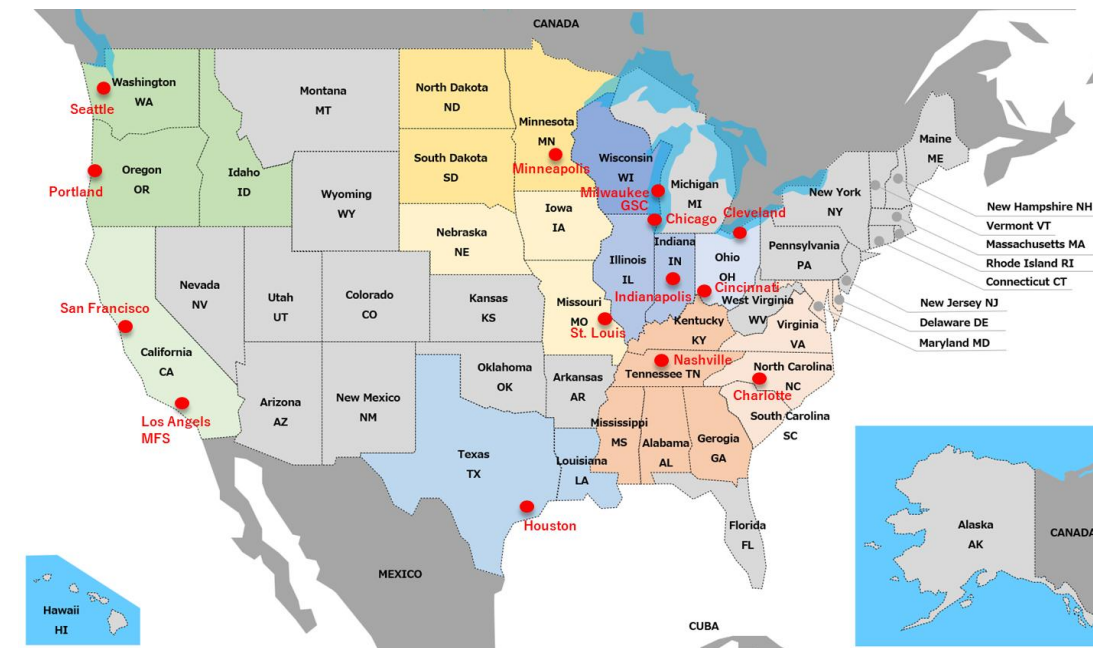
## 会社概要

会社名	Ellison Technologies, Inc. (略称: Ellison)
事業内容	工作機械等の販売及びサービス
創立	1955年
売上高	338million USD(2024年3月期)
人員	392名(2024年10月末日時点)
株主	三井物産100%

## 特徴

1. 工作機械の販売会社として全米最大手の一角
2. DNS代理店として世界No.2
3. 機械単体売りではなく、Turnkey Solutionを提供
4. 幅広い産業、大手から町工場までをカバー

## 販売地域 (26州で事業展開)



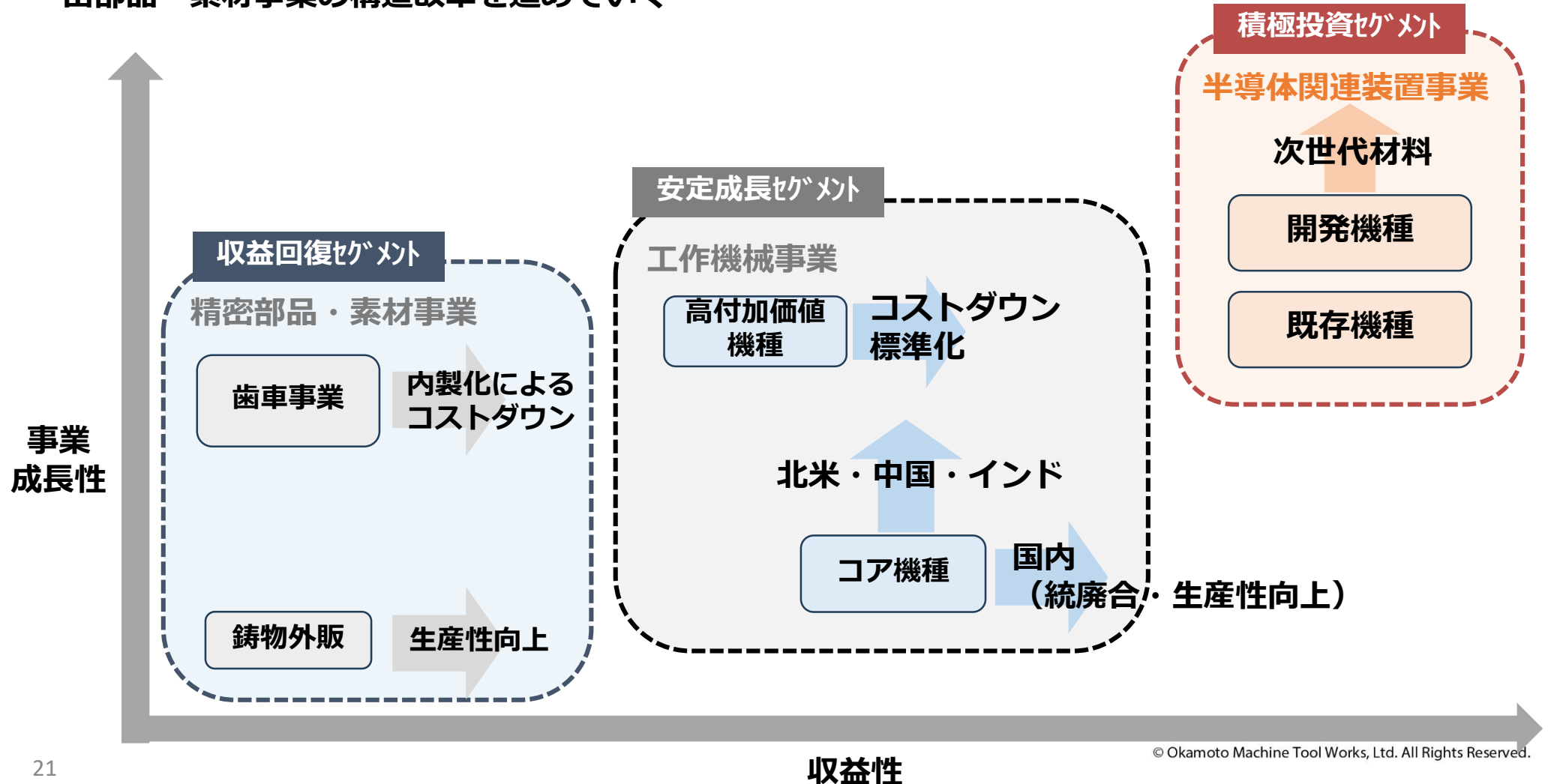
● Ellison支店所在地

出所：三井物産提供資料より



# 中長期戦略 事業ポートフォリオ

- 中長期戦略では半導体事業を積極投資セグメントとして位置付け、次世代材料領域にて事業拡大を図る
- 工作機械事業では、収益性の高いコア機種での成長を図るとともに、高付加価値機種へのテコ入れ、精密部品・素材事業の構造改革を進めていく



# 半導体関連装置事業 中計戦略骨子

## 半導体

### I .成長投資の検証・実行管理

(成長投資の実行と管理)

### II .半導体関連装置事業の収益力維持・向上

(先行開発、新市場開拓・シェア拡大の中で最大限採算を維持・向上、BwithBの推進)

#### ① Siウェハ向けポリッシャのシェア維持

- ・従来機に対し更なる生産性向上を実現する機種開発
- ・中国アフターサービスの充実
- ・国内テクニカルセンターの最大活用等

#### ② 次世代機種の新規開発

- ・Siウェハ加工プロセス高度化対応、パワー半導体(SiC, GaN)、通信デバイス向(LT/LN)ウェハ対応のポリッシャ並びにグラインダの開発 (競争力のある製品開発)

#### ③ 半導体装置に関連に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新

- ・技術的な要求に対する実証試験を通じた受注確度の向上、並びにデモ機での設計・製造品質の作りこみ

#### ④ 設計・製造キャパシティの強化

- ・投資含め、売上300億円を支える生産体制の構築
- ・九州テクニカルセンターによる売上拡大
- ・必要人員の増員、必要フロアの確保

## 技術開発棟・ショールームに係る不動産購入

2024年9月30日 技術開発棟・ショールームに係る不動産を取得  
2025年3月までに先方設備を搬出後、当社への引き渡しを予定  
取得・改修費用などは5月に第三者割当増資で調達した9,806百万円から充当

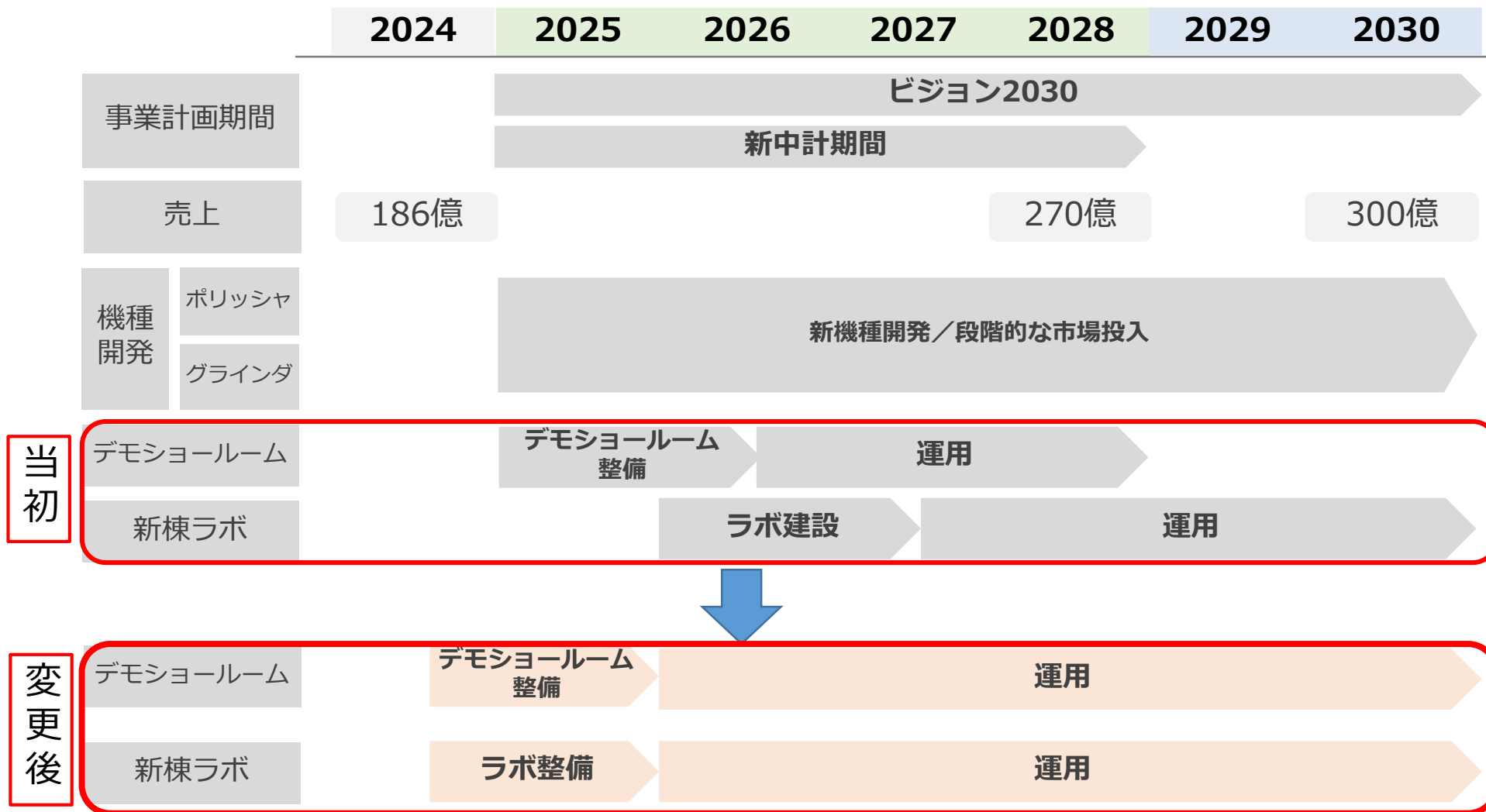
群馬県安中市  
岡本工作機械製作所本社



技術開発棟・ショールーム予定地  
埼玉県さいたま市

# 技術開発棟・ショールームに係る不動産購入

想定より前倒して技術開発棟・ショールームの運用を開始するもの





# 半導体関連装置事業 生産体制強化 九州地区半導体関連拠点

前中期経営計画期間の施策で半導体産業の一大集積地となる九州で拠点を確保  
計画に沿って生産体制を強化中

伊万里市  
九州テクニカルサポートセンター



お客様のサポートをより近くで可能に  
パーツ対応やメンテナンスを担当



半導体分野での自動化に実績

嘉島町  
プレシード

2023年5月

九州テクニカルサポートセンター  
開設

2023年5月

プレシード資本業務提携

2023年11月

大和工機 完全子会社化



大型のクリーン工場を備え  
半導体関連の大型装置やライン設備の生産が可能

© Okamoto Machine Tool Works, Ltd. All Rights Reserved.

# 工作機械事業 中計戦略骨子

## 工作機械

### I. 成長市場での市場シェア拡大

(中国・アメリカでの売上拡大、インド市場開拓)

### II. 工作機械事業の収益力改善

(機械本体収益改善、BwithB推進)

#### ① 機械採算管理・売価見直し

グローバルでの機種別採算管理と、機種統合・再構築（値付け・開発含め）を推進。また、価値に応じた適正価格を追求

#### ② コア機種拡販（海外/国内）

コア機種である平面研削盤を中心とした、北米・中国・インド展開。市場に適応した機種の拡販を進める

#### ③ VE・設計標準化

過去の低採算機種の分析を踏まえ、標準化を徹底していく。また、新機種開発の中でVE推進し、既存機種へ展開しコスト低減を図る

#### ④ 国内生産・サービス強化投資

生産革新（OPS・直送化等）による品質向上・コスト低減、自動倉庫投資含めたBwithBの推進

# 精密部品・素材（歯車・鋳物（外販））事業 中計戦略骨子

## 精密部品・素材 （歯車・ 鋳物（外販））

### I. 歯車事業 安定収益体制構築

（事業の幅を横に広げながら、内製化推進・組織強化を図る）

### II. 鋳物事業モノづくり改善/外販推進

（収益改善に向けた不良率低減・生産性の向上）

#### ① 【歯車】 高付加価値製品の拡販

強みを生かした高付加価値製品の拡販/技術向上を通し、業界内でのポジションを高め、より安定した売上を確保できる体制を構築する

#### ② 【歯車】 府中第二工場（新工場）での内製化推進

新工場投資により増加した生産キャパシティの有効活用（内製化） ・ 高い生産性の実現

#### ③ 【歯車】 安定した収益を確保できる体制の構築

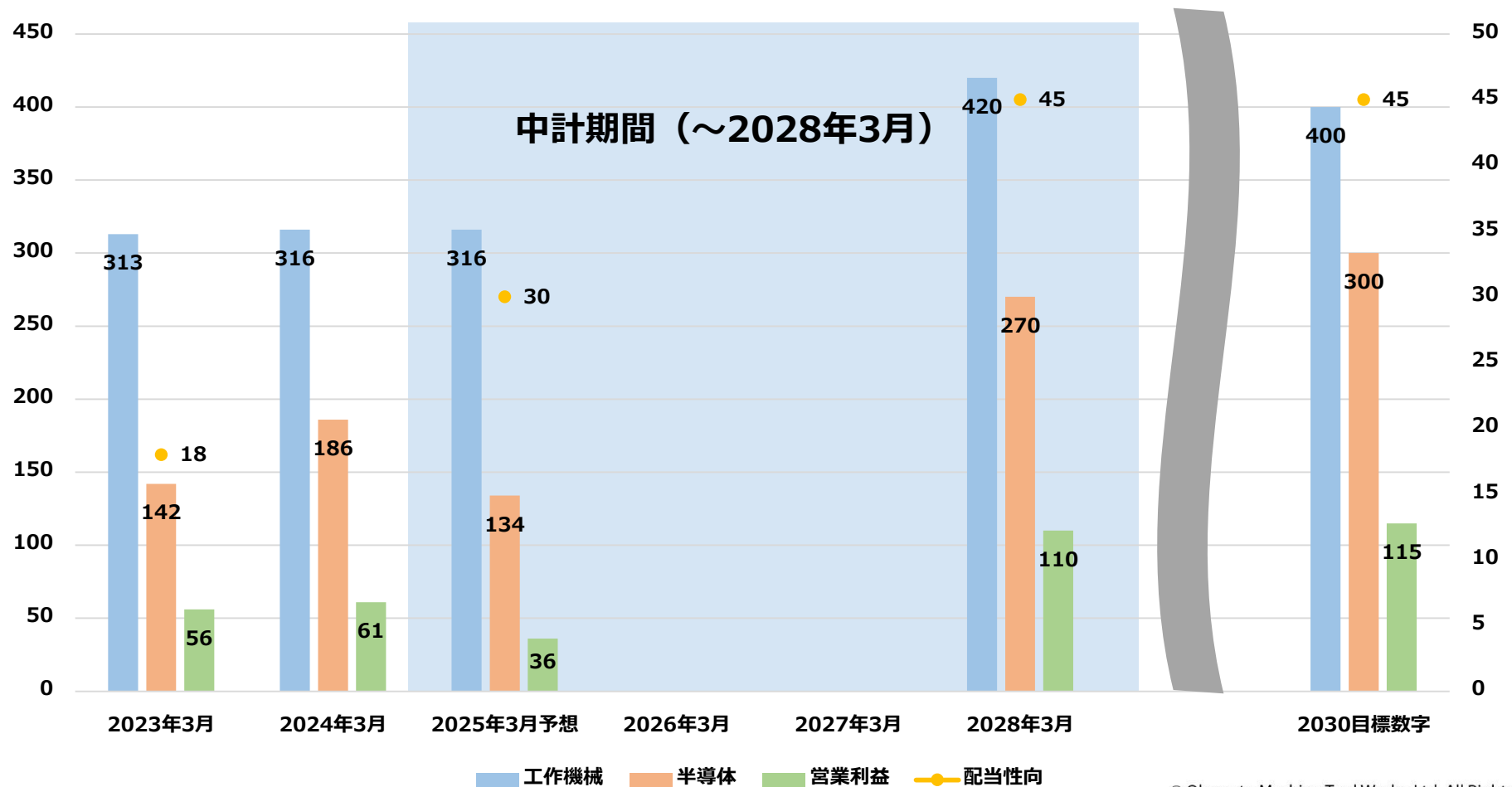
採算管理・計数管理体制の強化と、先回りした施策実行（価格コントロール等）

#### ④ 【鋳物（外販）】 生産体制強化・外販推進

安定品質・安定生産を実現するための技能伝承及び、人員採用。特に木型の開発、生産技術のレベルを維持・向上させていく体制づくり/新規顧客の開拓による売上高の拡大（外販）

# 新中計数値目標

2028年3月期に「ビジョン2030」で掲げた数値目標水準への到達を目指す  
また、配当性向30%目標を見直し、2028年3月期45%の配当性向を目指す



# 自己株式の取得について

2024年11月12日、株主の皆様への還元を一層強化し、資本効率の向上を図るため、当社自己株式の取得を実施

(1) 取得する株式の種類	当社普通株式
(2) 取得する株式の総数	85,000株(上限) (自己株式を除く発行済株式総数に対する割合 1.27%)
(3) 株式の取得価格の総額	300,000,000円(上限)
(4) 取得する期間	2024年11月13日～2025年3月31日
(5) 取得方法	自己株式取得に係る取引一任契約に基づく東京証券取引所における市場買付

(2024年11月26日取得終了)

- ・ 取得株式数 : 70,900株 ※取得率 : 83.41%
- ・ 取得価格 : 299,845,000円 ※取得率 : 99.95%



**Okamoto**

# 3. Si貫通電極ウェーハ全自動研削装置

## JST研究成果最適展開支援プログラム開発成功

# Si貫通電極ウェーハ全自動研削装置

2016年10月にJSTの研究成果最適展開支援プログラムとして開始され、2024年7月にかけて当社にて実用化開発を進めていた「Si貫通電極ウェーハ全自動研削装置」

**2024年10月29日 JSTより開発成功認定を受けたことをJST/当社にて発表**

半導体回路の性能向上はこれまでムーアの法則に沿い限りなく微細化を突き詰めてきたが、それも限界に近づき、回路を平面ではなく立体として集積する積層化（3次元実装）が模索されている

ただ、コストの問題や歩留まりの低さが制約となり一部の高性能デバイスでしか実用されていなかった

本開発の成功によりビアミドルSi電極形成プロセスが効率化され、接続電極を用いない直接積層が可能に



Equipment Front End Module (EFEM)

洗浄部

研削部

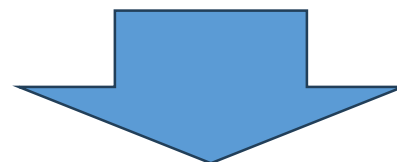


研削部

洗浄部

EFEM

今回開発した装置



今後は、デバイスメーカーとの協業を通じ、ハイエンド用だけではなく、

- 普及著しいIoT用
- AI（人工知能）用

など、様々なデバイスへの適用を模索・検討

# Appendix

(ご参考資料)



2024年12月11日～13日 SEMICON JAPAN2024に出展

「まっ平をつくる」半導体製造装置のウェーハ用グラインダー

「原子レベルでの無欠陥表面品質を作る」ポリッシャー に強みを持つ当社の、  
高硬度材（炭化ケイ素、窒化ガリウム）に対する加工技術・積層化領域での技術の優位性を訴求

## ハイブリッド材料の総合砥粒加工装置

FOWLP, PLP, TSVウェーハの研削  
～半導体及び先端パッケージ技術の進化への対応～  
FOWLP/PLP研削におけるCu+モールド樹脂加工  
及び複合材平坦化技術により、IoT社会の実現へ貢献します

**加工実例** 積層技術に対応した、パッケージ材料、TSVウェーハ  
様々な樹脂・金属・膜の複合素材

ハイブリットウェーハ  
(異種基板)  
の総合砥粒加工装置

次世代高周波通信  
デバイス用  
ハイブリットウェーハ

電子部品用  
各種セラミックス材料

TSV 積層ウェーハ  
オートTTVコントロールによる  
高精度研削

BGテープ高精度研削  
バンブウェーハの高精度加工

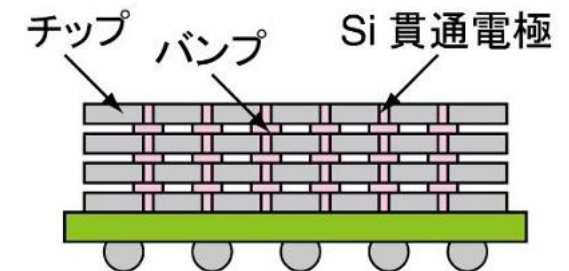
SiC加工のトータルソリューション  
インゴットからウェーハ工程まで



**加工実例** 積層技術に対応した、パッケージ材料、TSVウェーハ  
様々な樹脂・金属・膜の複合素材

### TSV 積層ウェーハ

オートTTVコントロールによる  
高精度研削



3次元実装した回路のイメージ

# 世界唯一の総合砥粒加工機メーカー

## 会社概要

会社名 英文	株式会社 岡本工作機械製作所 Okamoto Machine Tool Works, Ltd.
創業	大正15年11月
設立	昭和10年6月
資本金	97億8,370万円
本社所在地	〒379-0135 群馬県安中市郷原2993番地
事業内容	【工作機械・半導体関連装置の製造・販売】 工作機械事業（平面研削盤・成形研削盤・内面研削盤・円筒研削盤・ 歯車研削盤・専用研削盤・精密歯車・鋳物） 半導体関連装置事業（グライディングマシン・スライディングマシン・ホーリングマシン・ラッピングマシン・ガラス基板研磨装置）
従業員数	連結: 2,303名 単体: 486名 ※2024年9月末現在



# 国内拠点、海外拠点



生産・販売拠点	
国内	15拠点
北米	4拠点
欧州	3拠点
中国	4拠点
アジア	3拠点

## 本資料に関するお問い合わせ先

**株式会社 岡本工作機械製作所**  
**総務部**  
**TEL 027(385)5800**

### 【本資料お取扱い上のご注意】

本資料は、株式会社岡本工作機械製作所(以下、当社)をご理解いただくため、当社が作成したもので、当社への投資活動勧誘を目的としておりません。

本資料を作成するにあたっては正確性を期すために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。

本資料中の業績予測ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果があります。